

お客様各位

株式会社エンプラス半導体機器

SEMICON JAPAN 2014 出展のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社は「セミコン・ジャパン 2014」に出展させていただきます。

システム LSI・パワーデバイスをはじめとする次世代の高性能デバイスに向け、微細化・多ピン化・高速化・高発熱化に対応した IC ソケットを多数展示しております。

ご多忙中とは存じますが、この機会に是非ご来場賜り、弊社のブースをご高覧くださいます様、よろしくお願い申し上げます。

世界のトップメーカーが認める技術と品質で多品種少量生産のニーズにお応えするエンプラスの Connection Solution を是非ご覧下さい。

敬 具

記

- 会 期 2014年12月3日（水）～5日（金） 10：00～17：00
- 会 場 東京ビックサイト HALL 1 小間番号：1017
- 出展製品

1. 高発熱対応ソケット
 - － ヒーター、センサー付き多ピンソケット
 - － 個別温度コントロールシステム
2. 車載対応ソケット
 - － ヒートシンク付きオープントップソケット
 - － 車載センサーソケット
3. 微細ピッチ対応ソケット
 - － 微細ピッチローコストソケット（0.35mm、0.4mm）
 - － WLCSP・アプリケーションプロセッサ用ソケット
 - － カスタム QFN ソケット
4. テストソケット
 - － 高電流対応ケルビンコンタクトソケット
 - － 高周波対応カプセルコンタクトソケット
 - － ローコストプローブピンソケット
 - － IGBT ソケット
5. 高寿命化／高温対応
 - － ES メッキソケット（テスト・バーンイン用）

以 上

ご来場予定表

ご来場の予定をお聞かせください。ささやかではありますが、粗品を準備してお待ちしております。

ご来場予定日時を○で囲んで下さい

日程	時間						
12月3日(水)	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
12月4日(木)	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
12月5日(金)	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00

貴社名: _____

ご芳名: _____

*ご来場予定がお決まりでしたら、上記にご記入の上、そのまま FAX 頂ければ幸いに存じます。

■出展小間位置



エンプラス半導体機器展示ブース
HALL 1 1017

